

中電流離子佈植機 注意事項

注意事項

1. 佈植能量勿低於10keV或高於200keV，劑量勿低於1E12或高於5E15。
2. 晶圓為2吋或破片，限定以真空膠帶粘妥於6吋/8吋晶圓上，6吋/8吋晶圓外圈2公分的範圍與晶背勿黏貼到任何東西(包括破片、真空膠帶等)。
3. 若晶圓為非標準如下標示，於安裝及佈植發生破片時，將不予負責。
 - 3.1 4吋與6吋需用夾子夾晶片，需卡在8吋載具上有破片風險。
 - 3.2 黏貼的破片若不牢靠時，容易破片掉片的風險。
 - 3.3 晶片偏薄更容易有破片與缺角的風險。
 - 3.4 4吋與6吋晶片太厚無法卡載具。
 - 3.5 晶片不符載具時，卡片時會比較緊也容易破片。
 - 3.6 8吋晶片2片黏在一起，不是標準晶片的重量，吸筆承載也有掉片的風險。
4. 使用到光阻者，請務必硬烤烤乾。
5. Tilt角度不得超過60度。若未註明Tilt及Twist角度, 預設值為Tilt : 7°、Twist : 22°。
6. 最表面層若為大面積金屬膜，請勿送件。